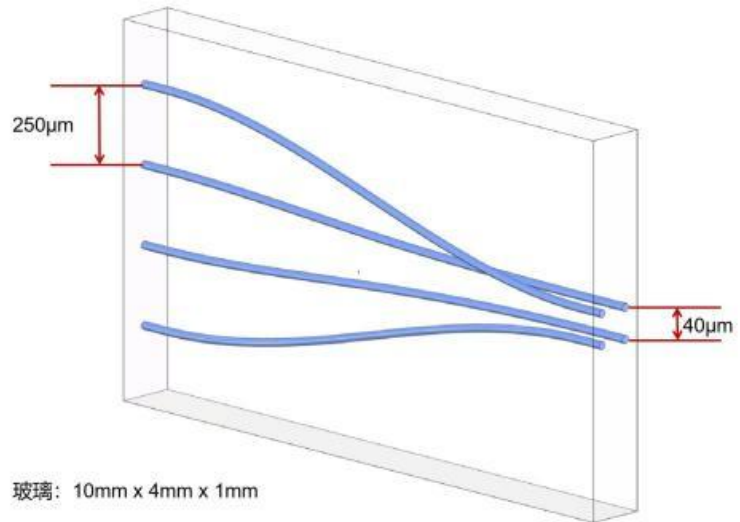


多芯 FIFO 波导芯片 (4 芯光波导芯片)

主要特征:

- 基于先进的 3D 激光直写技术
- 从 VIS 到 NIR 都有较高的光学透过率
- 与光纤相似的模场直径
- 较低的介电损耗, 适用于 20GHz+
- 兼容 TGV 通孔技术、硅光工艺平台
- 高尺寸稳定性、热稳定性和化学稳定性
- 低传输损耗和耦合损耗
- 圆形截面、大小可控、兼容高阶模式



应用领域:

- 高密度光通信、光互连;
- 3D 光电集成, 微纳光学器件;
- 光学传感、光计算;
- 量子计算、量子信息处理。

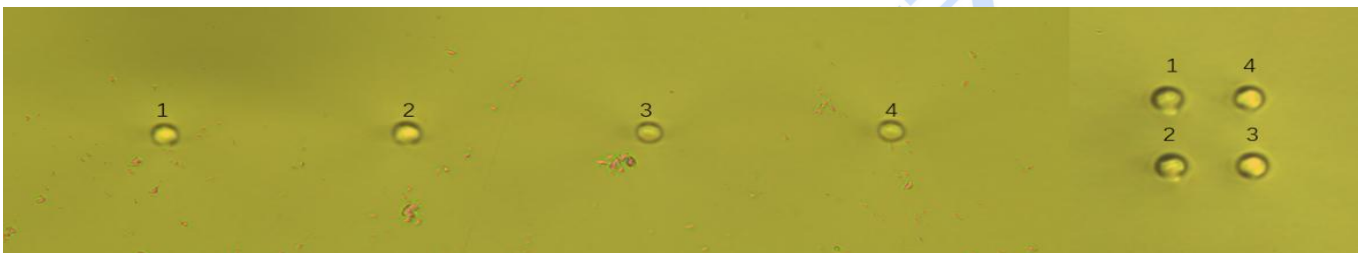
产品参数:

参数项目	最小	典型值	最大	备注
工作波长(nm)	380nm	1550nm	2400nm	
边缘耦合损耗 (dB/fac)		0.25dB/face		
传输损耗 (dB/cm)		0.08dB/cm	0.1dB/cm	直波导/大弯曲半径(> 20mm)波导
工作温度 (°C)	-10°C		85°C	
写入深度 (μm)	50μm		400μm	
偏振相关损耗 PDL(dB)	0.05dB		0.1dB	
截面直径(μm)	5μm		25μm	

订购信息:

订购信息	玻璃材料	备注
任意三维波导结构	Corning EAGLE XG Glass、Schott BOROFLOAT 33、各类无碱高硼玻璃、磷酸盐玻璃、光敏玻璃、晶体材料等	小弯曲半径的波导器件需提前弯曲损耗标定

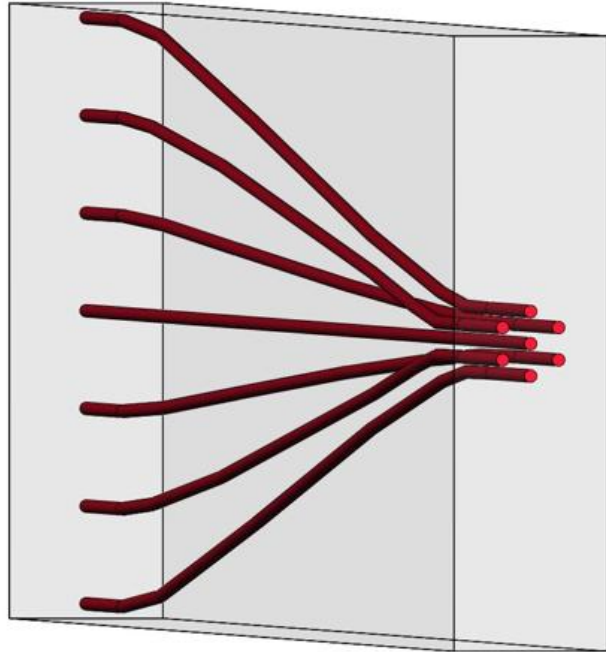
四芯光纤扇入扇出芯片截面 示图:



多芯 FIFO 波导芯片 (7 芯光波导芯片)

主要特征

- 基于先进的 3D 激光直写技术;
- 从 VIS 到 NIR 都有较高的光学透过率;
- 与光纤相似的模场直径;
- 较低的介电损耗, 适用于 20GHz+;
- 兼容 TGV 通孔技术、硅光工艺平台;
- 高尺寸稳定性、热稳定性和化学稳定性;
- 低传输损耗和耦合损耗;
- 圆形截面、大小可控、兼容高阶模式。



应用领域:

- 高密度光通信、光互连;
- 3D 光电集成, 微纳光学器件;
- 光学传感、光计算;
- 量子计算、量子信息处理。

产品参数:

参数项目	最小	典型值	最大	备注
工作波长(nm)	380nm	1550nm	2400nm	1310/1550 波长匹配 不同应用场景
边缘耦合损耗 (dB/fac)		0.25dB/face		
传输损耗 (dB/cm)		0.08dB/cm	0.1dB/cm	直波导/大弯曲半 径(> 20mm)波导
弯曲损耗(dB/cm)		0.2dB/cm	0.3dB/cm	
写入深度 (μm)	50μm		400μm	
偏振相关损耗 PDL(dB)	0.05dB		0.1dB	

截面直径(μm)	5 μm		25 μm	
-----------------------	-----------------	--	------------------	--

订购信息:

订购信息	玻璃材料	备注
任意三维波导结构	Corning EAGLE XG Glass、Schott BOROFLOAT 33、各类无碱高硼玻璃、磷酸盐玻璃、光敏玻璃、晶体材料等	小弯曲半径的波导器件需提前弯曲损耗标定

7 芯光纤扇入扇出芯片截面 示意图:

